

第15回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成28年9月7日(水) 10:30~16:00

場所:中京大学 工学部 1号館 3F(132室) (愛知県名古屋市)

時間	題目	講演者
	司会 山中 公博 (中京大学)	
10:30~ 11:50	『トポロジー最適化による電子基板の熱設計』 (40分)	○野村 壮史((株)豊田中央研究所)、 Ercan M.Dede, Toyota Research Institute of North America、西脇眞二 (京都大学)
	『2 モーターハイブリッド向け トランスミッション直載型 高出力密度パワーコントロールユニット』 (40分)	○樫村 之哉((株)本田技術研究所)
11:50~ 12:50	昼食休憩	
12:50~ 13:00	委員会議事	
	司会 松嶋 道也 (大阪大学)	
13:00~ 14:20	『パワーSi MOSFET内部のホットスポット解析』 (40分)	○畠山 友行(富山県立大学)、木伏 理沙子(山口東京理科大学)、石塚 勝 (富山県立大学)
	『カートリッジ方式による定常熱伝導率測定法』 (40分)	○大串哲郎((株)アドバンスドナレッジ研 究所)
14:20~ 14:40	休憩	
	司会 青島 正貴 (トヨタ自動車(株))	
14:40~ 16:00	『耐熱疲労特性向上を目指したSn-Ag-Bi-In系 はんだの研究』 (40分)	○日根 清裕(パナソニック(株)、大阪大 学)、秋山真之介(パナソニック(株))、乗峯 笙汰、三原 一樹(大阪大学)、北浦 秀 敏、古澤 彰男(パナソニック(株))、上西 啓介(大阪大学)
	『電子機器用非鉄金属の材料設計』 (40分)	○安藤 哲也(室蘭工業大学)

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。